

## 产品规格

项目	描述
PCB	3.5 inch
	146mm*102mm , 高度 15mm
	黑色
CPU	FCBGA828/0.65mm/28nm 制程, 21mm x 21mm
	RK3399 SOC Cortex 双核 A72 2.0GHZ+四核 A53 1.6GHZ, TDP:5W
GPU	Mali854 650M325M Tri/Sec2600M pixel/sec
内存	LPDDR3 板载 4GB ;
存储	EMMC 8GB/16GB/32GB/64GB 可选 (默认 16GB )
	1*SATA Port , 支持 5V 供电;
显示接口	1. eDP 1.3x1 接口; 2. LVDS 接口支持单双通道 18bit,24bit , 1920*1200 dual channel,1600*1200 single channel; 3. 支持 HDMI2.0 ;
网络及通讯	1 个 RJ45 千兆网口;
	具备蓝牙+WIFI 模块, 支持 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 协议, 2. 4G/5G 双频段 (可选); 支持蓝牙 4.0 协议, 双天线;
	Mini PCIe slot; SIM slot 采用标准卡 25mm*15mm ;
	支持 USB、PCIe 信号设备扩展;
GPS	内置 GSP 模块, 灵敏度: -159dBm 接收频率: 1575.42MHz 卫星; 通道: 20 通道 定位精度: <10m (选配);
图像旋转	支持重力感应自动转屏功能 (选配)
MIPI-CSI	支持 1300W 像素 MIPI 摄像头功能 (选配)
实时时钟	内置实时时钟供电电池, 支持定时开关机;
系统看门狗	支持硬件看门狗;
接口设备	支持红外遥控制;
	7 个 USB HOST, 2 个外设置 USB3.0/2.0(其中一个支持 OTG 插针), 5 个内置 USB2.0 插针;
	4 组 RS232, 其中一个可选 RS485 ;
	6 组 IO 检测口(可配置 I2C 接口) , 支持红外感应;
	TF 扩展卡;
	D class 超大内置喇叭, 6W*24R 支持耳机接口输出;
	支持麦克风 3.5mm Jack ;预留插针;
电源输入	DC12V/2A (带 DC-JACK 和 1*4pin Wafer co-lay );
使用环境	操作温度: -10℃-60℃ 存储温度: -20℃-70℃, 相对湿度 95%
认证要求	3C, FCC, CE
操作系统	Android 7.1*2